## 特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	17	NOV	2005
WIPO			F 3**

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-04-202	今後の手続きについ	ては、様式PCT/	I PEA/4168	を参照するこ	٤.
国際出願番号 PCT/JP2004/017911	国際出願日 (日.月.年) O2.	12. 2004	優先日 (日.月.年) O	3. 12. 2	003
国際特許分類(I P C)Int.Cl. <sup>7</sup> C22C9/04					
出願人 (氏名又は名称) 株式会社キッツ					
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の	規定に従い送付する。		#審査報告である。		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	と含めて全部で	ページ	からなる。		
3. この報告には次の附属物件も添付される。		o.			
☑ 補正されて、この報告の基 囲及び/又は図面の用紙()				含む明細書、	請求の範
「 第 I 概 4 . 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		おける国際出願の開	示の範囲を超えた	補正を含むも	のとこの
b. 「 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す。 (実施細則第802号参照)	ように、電子形式によ	る配列表又は配列表		の種類、数でルションのである。	を示す)。
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	 と含む。		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b></b>
<ul> <li>第 I 欄 国際予備審査報</li> <li>第 I 欄 優先権</li> <li>第 II 欄 新規性、進歩性</li> <li>第 IV欄 発明の単一性の</li> <li>▼ 第 V欄 P C T 35条(2)</li> <li>けるための文庫</li> </ul>	E又は産業上の利用可能 の欠如 に規定する新規性、進				を裏付
□ 第VI欄 ある種の引用式 第VI欄 国際出願の不偏 □ 第VII欄 国際出願に対す					
国際予備審査の請求書を受理した日		国際予備審査報告を	 作成した日		
27. 07. 2005			0. 2005		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)		特許庁審査官(権限の近野 光知	のある職員)	4 K	9260
郵便番号100-8915			•		

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

東京都千代田区額が関三丁目4番3号

第	I欄	報告の基礎
1.	音部	に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
		出願時の言語による国際出願
		出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		□ 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
		国際公開 (PCT規則12.4(a))
		□ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))
2.	20	報告は下記の出願咨類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出され
	たま	替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
		出願時の国際出願書類
	(V)	明細書
		第 1-16 ページ、出願時に提出されたもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第       ページ*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	<b>設求の範囲</b>
		第 <u>2-7</u> 項、出願時に提出されたもの
		第
		第1       項*、2005.07.27       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第二       項*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの
	_	
	V	図面 <b>第1-0</b>
		第 <u>1-9</u>
		第       ページ/図*、
		配列表又は関連するテーブル
	E.mJ	配列表に関する補充欄を参照すること。
3.		補正により、下記の書類が削除された。
		□ 明細書 第 ページ
		[] 請求の範囲 第 項
		□ 図面 第第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
		<ul><li>□ 配列表(具体的に記載すること)</li><li>□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)</li></ul>
		は、記り級に民産するケーノル(条件的に記載すること)
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則 70.2(c))
		_
		□ 明細暋 第 ページ □ 請求の範囲 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
		「」 請求の範囲 第 項 □ 図面 第 第 ページ/図
		配列表(具体的に記載すること)
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
* 4	. R	該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

## 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/017911

見解			
新規性(N)		1-7	_ 有
	請求の範囲		_ 無
進歩性(IS)	請求の範囲	1-7	_ 有
	請求の範囲		_ 無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-7	_ 有
	請求の範囲		_ 無
文献及び説明(PCT規則)	70. 7)		
請求の範囲1~7に係	る発明は、	国際調査報告で引用された文献に対して新規性	及び
進少性を有する。上記 温度範囲内で凝固する	文献には、 金属間化台	「固相線を超えた液相線との間の温度域である 合物を合金中のデンドライト間隙に晶出」させる O点は当業者といえども容易に想到し得ないもの	変し
ユッテコキア ア アーファット 一方	1 みょう ヱァ	へたいさい(光光・1・)、ことには かき日 )を指立に、復せいてもか	では
か記載されておりず、	しかもてい	り点は当業者といえとも容易に想到し待ないもの	
か記載されておらず、る。	しかもてい	J点は当業者といえとも各易に想到し侍ないもの	( ( )
か記載されておらず、る。	しかもてい	J点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、る。	C114670	J点は当業者といえとも各易に想到し <b>侍ないも</b> の	
か記載されておらず、る。	C 13 & C 0.	J点は当業者といえとも各 <b>多に想到し</b> 得ないもの	
か記載されておらず、る。	C 13 & C 0.	7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、る。	C / 3 & C / C	7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、る。	C 13 & C 0.	J点は当業者といえとも各参に想到し <b>侍</b> ないもの	
か記載されておらず、	C 13 & C 0	7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、	C 13 & C 0.	7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、る。	C 13 & C 0.	J点は当業者といえとも各参に想到し <b>得ないも</b> の	
か記載されておらず、		7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、		7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、	C 13 & C 10	J点は当業者といえとも谷易に想到し <del>何</del> ないもの	
か記載されておらず、		J.点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、		7点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、		J.点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、		J点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、		J点は当業者といえとも谷易に想到し侍ないもの	
か記載されておらず、		J点は当業者といえとも各参に想到し <del>何</del> ないもの	

## 日本国特許庁 27.07.05

## 請求の範囲

- [1] (補正後) 銅基合金の凝固過程において、固相線を越えた液相線との間の温度域である凝固温度範囲内で凝固する金属間化合物を合金中のデンドライト間隙に晶出させて溶質の移動を抑制することによりミクロポロシティを分散させると共に、前記金属間化合物の晶出により、前記銅基合金の凝固温度未満の温度で凝固する低融点金属又は低融点の金属間化合物の偏析を抑制し、前記低融点金属又は低融点の金属間化合物が前記ミクロポロシティに入り込んで分散晶出することにより、前記ミクロポロシティの発生を抑制することで、合金の健全性を向上させたことを特徴とする銅基合金。
- [2] 請求項1に記載の銅基合金において、少なくとも、Zn:5.0 ~10.0重量%、Se:0<Se≦1.5重量%を含有して、銅基合金の凝固過程における合金中のデンドライト間隙に、金属間化合物であるZnSeを晶出させた銅基合金。</p>
- [3] 前記金属間化合物の面積率を 0.3%以上 5.0%以下とした請求項1又は 2 に記載の銅基合金。
- [4] 請求項1乃至3の何れか1項に記載の銅基合金において、少なくとも、Bi:0.25~3.0重量%を含有して、銅基合金の凝固 過程における溶質領域中に低融点金属であるBiを分散して晶出させた銅基合金。
- [5] 前記低融点金属又は低融点の金属間化合物の面積率を0.2%以上2.5%以下とした請求項1又は4に記載の銅基合金。
- 請求項1乃至5の何れか1項に記載の銅基合金において、少なくとも、Zn:5.0~10.0重量%、Sn:2.8~5.0重量%、Bi:0.25~3.0重量%、Se:0<Se≦1.5重量%、P:0.5重量%未満、及び残部Cuと不可避不純物としてPb:0.2重量%未満からなる組成を有した銅基合金。</li>
- [7] 請求項1乃至6の何れか1項に記載の銅基合金を用いて製造した鋳塊、又はこの銅基合金を加工成形した接液部品。